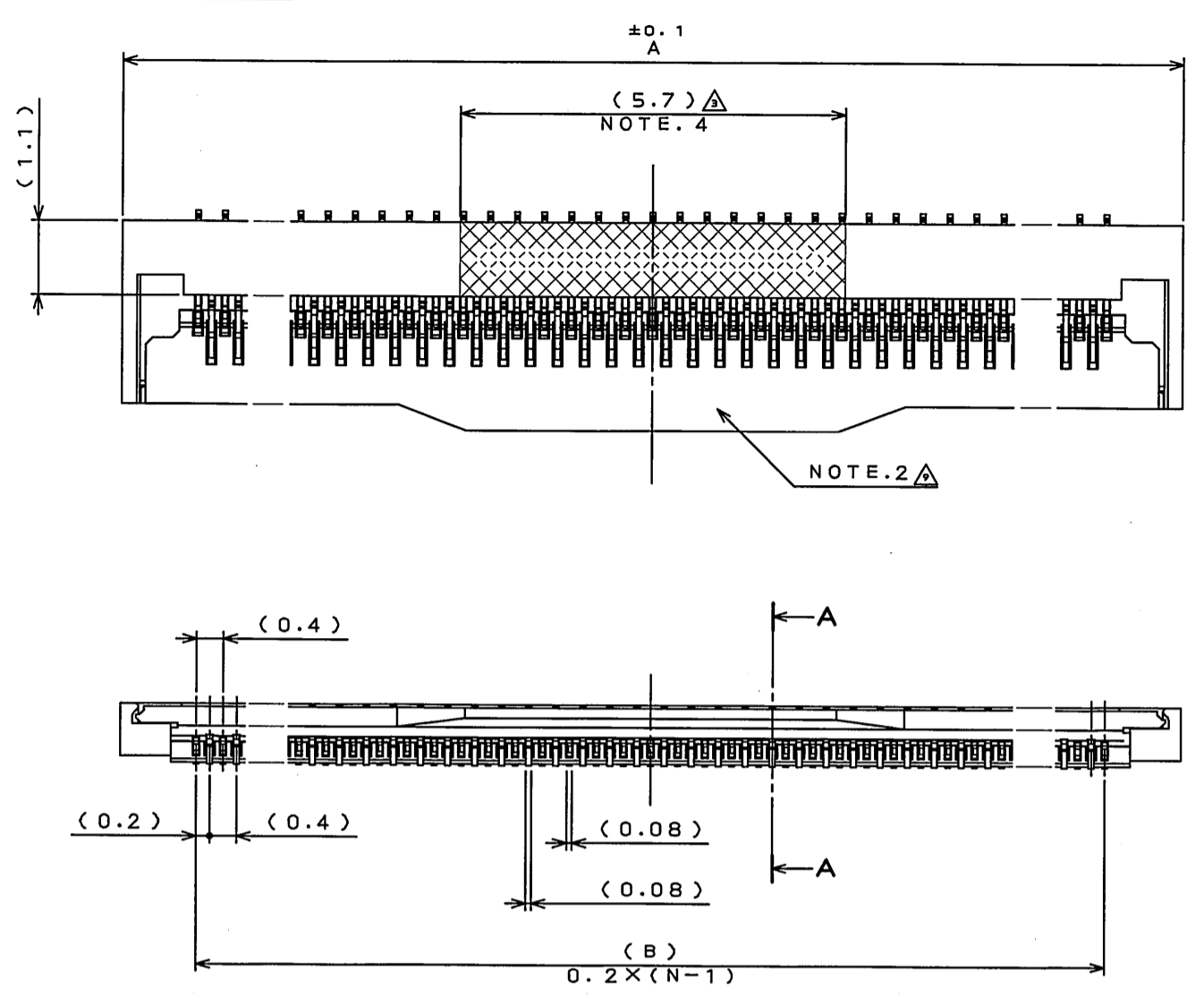
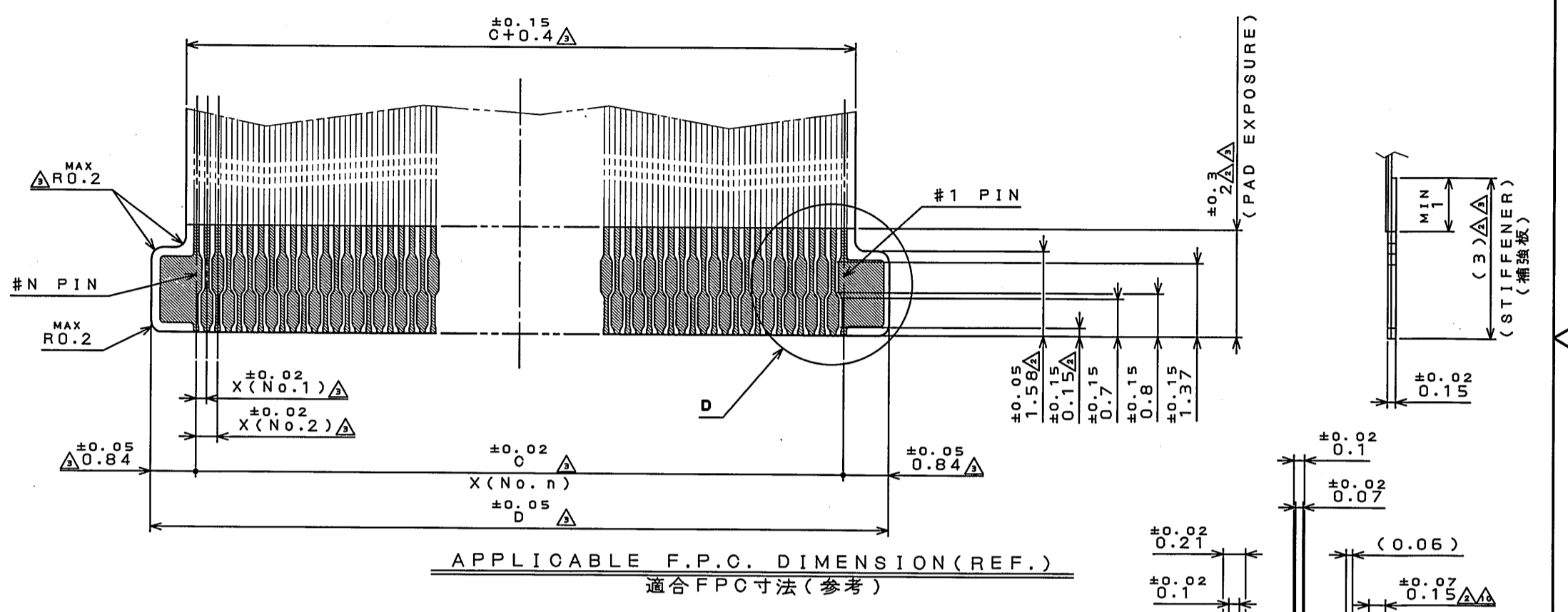
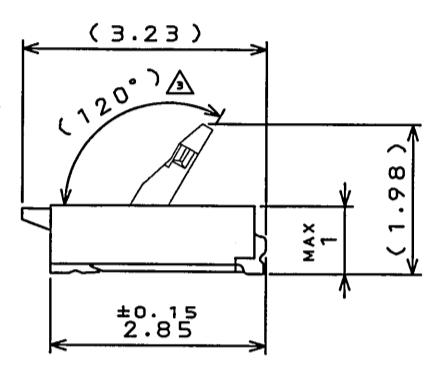


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
8	25.May.2010	069988	Added New Items		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
9	9.Sep.2010	070484	Changed Marking Position of Lot Number		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
10	27.Oct.2010	070937	Changed Applicable F.P.C. Dimension(REF.)		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI

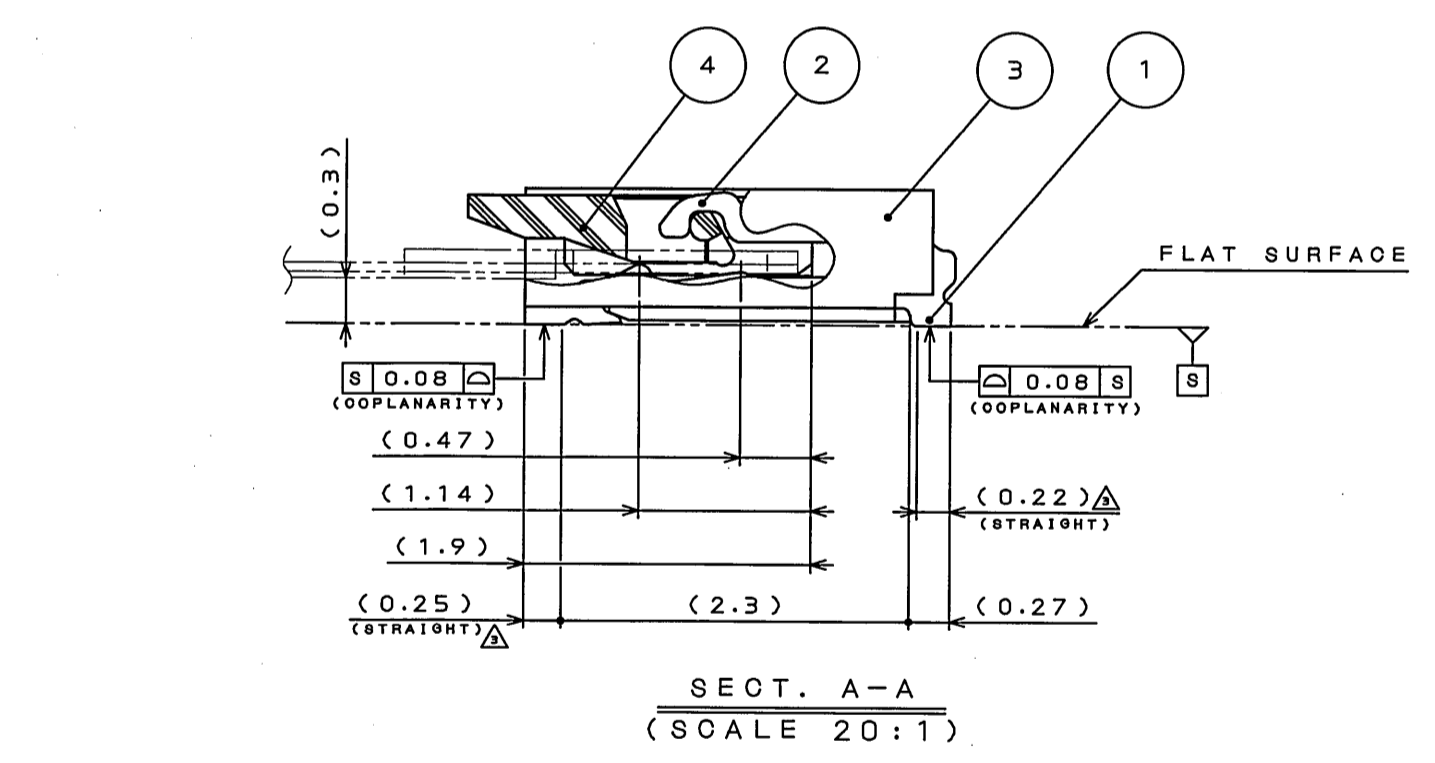


△ TABLE 3. DIMENSIONS

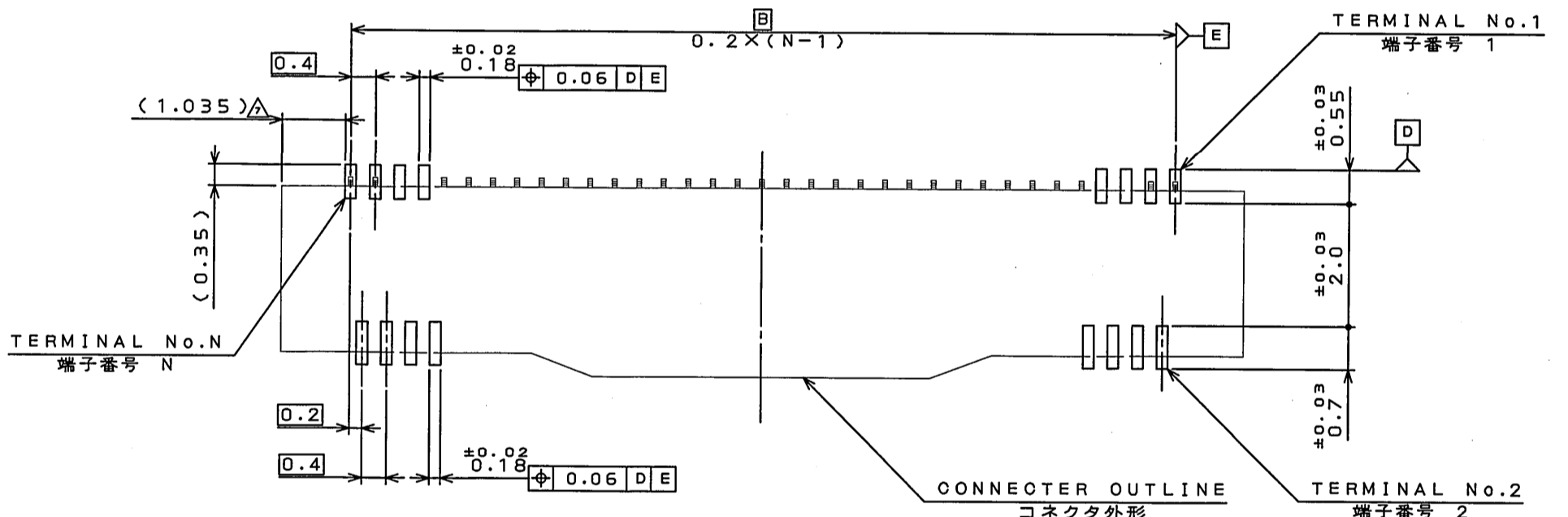
NO.	X
1	0.2
2	0.4
3	0.6
.	.
.	.
n	0.2 * (n-1)



APPLICABLE F.P.C. DIMENSION (REF.)
適合FPC寸法(参考)

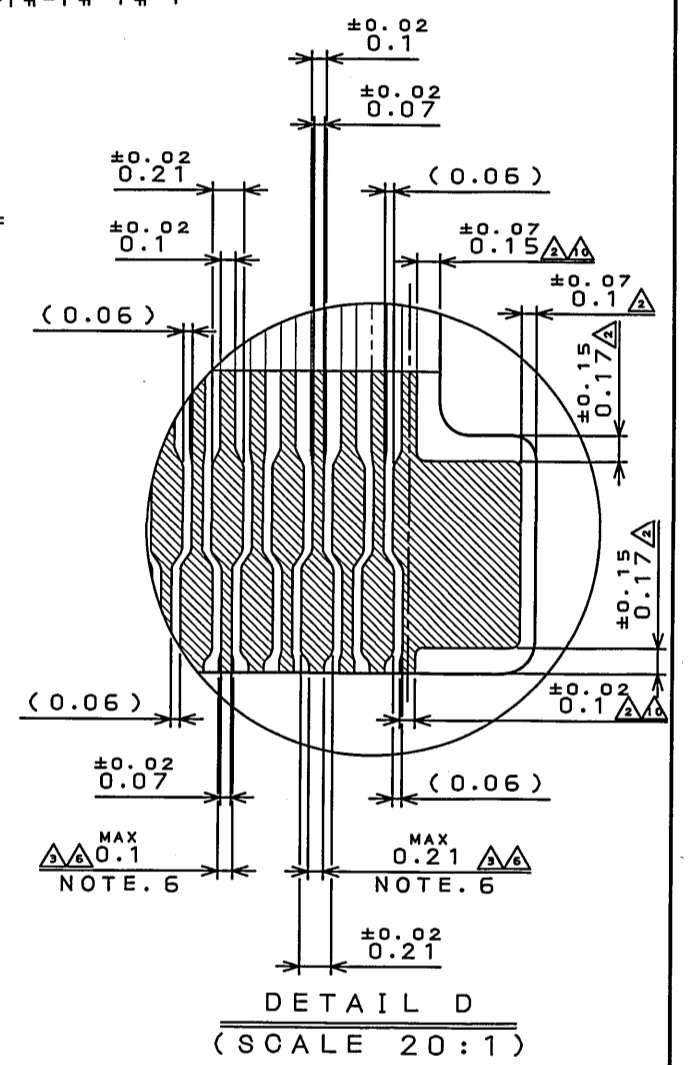


SECT. A-A
(SCALE 20:1)



MATHING SIDE
嵌合側

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)



DETAIL D
(SCALE 20:1)

NOTE
1. REFER TO TABLE2 FOR ROOMENDED FPC COMPOSITION.
2. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.
3. A NICKEL BARRIER EXISTS BETWEEN EACH CONTACT POINT AND TAIL.
4. THE DIMENSIONS OF VACUUMING COVER AREA.
5. OVERLAY EDGE INCLUDES A PROJECTION OF AN ADHESION LAYER.
6. DIMENSION OF TIP IS OPTIONAL WITHIN ABOVE RANGE WITHOUT PATTERN PEELING.

注記
1.推奨FPC構成はTABLE2参照のこと。
2.ロット番号がコネクタ上面に表記される。
3.各コネクタ接点とSMT部の間にはニッケルバリア有り。
4.吸着エリアを示す。
5.カバーレイ端面は接着層のみ出しを含む。
6.先端部寸法は上記寸法範囲内で任意とし、パターン剥離を要。

TABLE 2. ROOMENDED FPC COMPOSITION

COMPOSITION 層名	RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド

△ TABLE 1. DIMENSIONS

PRODUCT NO.	A	B	C	D
FF0825SA1	7.05	4.80	4.80	6.48
FF0829SA1	7.85	5.60	5.60	7.28
FF0841SA1	10.25	8.00	8.00	9.68
FF0851SA1	12.25	10.00	10.00	11.68
FF0871SA1	16.25	14.00	14.00	15.68
FF0881SA1	18.25	16.00	16.00	17.68

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
4	ACTUATOR アクチュエータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱プラスチック		COLOR:BLACK/色相:黒色 UL94V-0
3	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱プラスチック		COLOR:BEIGE/色相:肌色 UL94V-0
2	CONTACT 2 コンタクト2	(N-1) 2	COPPER ALLOY 銅合金		PARTIAL GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1μm以上
1	CONTACT 1 コンタクト1	(N+1) 2	COPPER ALLOY 銅合金		PARTIAL GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1μm以上

DOF-0-213E(05.08)

SIZE A2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.